

PCT/JP 2004/013030

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

08. 9. 2004

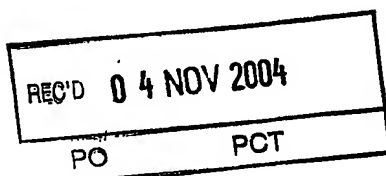
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 3 年 9 月 8 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 3 1 5 0 0 6  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 3 - 3 1 5 0 0 6 ]

出 願 人  
Applicant(s): 住友金属鉱山株式会社

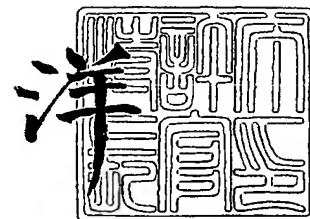


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 0 月 2 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 9 4 8 5 5

【書類名】 特許願  
【整理番号】 03SMM358  
【提出日】 平成15年 9月 8日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 H05B 33/14  
【発明者】  
    【住所又は居所】 千葉県市川市中国分3丁目18番5号 住友金属鉱山株式会社  
                        市川研究所内  
    【氏名】 行延 雅也  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000183303  
    【氏名又は名称】 住友金属鉱山株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100083910  
    【氏名又は名称】 山本 正緒  
    【電話番号】 03-5440-2736  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 039033  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 9718839

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

平滑な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層と、該透明導電アノード電極層に接着剤層により接合された透明基材とを備え、前記平滑な基板が透明導電アノード電極層から剥離可能であることを特徴とする透明導電積層体。

**【請求項 2】**

平滑な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成されたホール注入層と、該ホール注入層上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層と、該透明導電アノード電極層に接着剤層により接合された透明基材とを備え、前記平滑な基板がホール注入層から剥離可能であることを特徴とする透明導電積層体。

**【請求項 3】**

前記透明導電アノード電極層と接着剤層の間に、塗布法により形成された透明コート層を備えることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の透明導電積層体。

**【請求項 4】**

前記透明導電アノード電極層が、平均粒径 1～100 nm の貴金属含有微粒子で構成された網目状構造を有することを特徴とする、請求項 1～3 のいずれかに記載の透明導電積層体。

**【請求項 5】**

前記貴金属含有微粒子が、金又は銀の微粒子若しくは金と銀を含有する微粒子であることを特徴とする、請求項 4 に記載の透明導電積層体。

**【請求項 6】**

平滑な基板上に、溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電アノード電極層形成用塗布液を塗布・乾燥させて透明導電アノード電極層を形成すると共に、該平滑な基板として透明導電アノード電極層から剥離可能な基板を用い、得られた透明導電アノード電極層上に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする透明導電積層体の製造方法。

**【請求項 7】**

前記平滑な基板上に、溶媒中にホール注入性物質を含むホール注入層形成用塗布液を塗布・乾燥させてホール注入層を形成すると共に、該平滑な基板としてホール注入層から剥離可能な基板を用い、該ホール注入層上に透明導電アノード電極層を形成し、得られた透明導電アノード電極層上に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする透明導電積層体の製造方法。

**【請求項 8】**

前記透明導電アノード電極層上に、溶媒とバインダーを主成分とする透明コート層形成用塗布液を塗布・乾燥させて透明コート層を形成し、該透明コート層に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする、請求項 6 又は 7 に記載の透明導電積層体の製造方法。

**【請求項 9】**

前記透明導電アノード電極層形成用塗布液の導電性微粒子が、平均粒径 1～100 nm の貴金属含有微粒子であることを特徴とする、請求項 6～8 のいずれかに記載の透明導電積層体の製造方法。

**【請求項 10】**

前記貴金属含有微粒子が、金又は銀の微粒子若しくは金と銀を含有する微粒子であることを特徴とする、請求項 9 に記載の透明導電積層体の製造方法。

**【請求項 11】**

請求項 1～5 のいずれかの透明導電積層体から平滑な基板を剥離した透明導電アノード電極層又はホール注入層の剥離面上に、塗布法により形成されたポリマー発光層と、該ポリマー発光層上に設けたカソード電極層とを備えることを特徴とする有機 EL 素子。

**【請求項 12】**

請求項 6～10 の製造方法で得られた透明導電積層体から平滑な基板を剥離除去した後、透明導電アノード電極層又はホール注入層の剥離面上に、溶媒と高分子発光材料又はその前駆体とを含むポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥してポリマー発光層を形成し、

該ポリマー発光層上にカソード電極層を形成することを特徴とする有機EL素子の製造方法。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】透明導電積層体、有機EL素子及びその製造方法

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、液晶バックライト等の光源やディスプレイ等の表示装置に適用される有機エレクトロルミネッセンス素子（以後、有機EL素子と記す）の製造に構成部分の一部として用いられる透明導電積層体、その透明導電積層体を用いた有機EL素子、並びにその製造方法に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

エレクトロルミネッセンス素子は、液晶素子と違って自発光素子であり、無機蛍光体を発光材料として用いた無機エレクトロルミネッセンス素子（以後、無機EL素子と記す）が、ディスプレイ等の表示装置の一部に用いられている。ただし、無機EL素子は、発光色が限られていることや、作動電圧が高い等の問題があるため、適用分野が限られていた。

## 【0003】

近年、有機発光層と有機電荷輸送化合物層とを積層した2層構造を有する有機EL素子が提案され（特開昭59-194393号公報参照）た。この有機EL素子は、低電圧で駆動し、高輝度であって、種々の発光波長が容易に得られる等の特徴を有することから、実用化を目指して盛んに研究が行われている。

## 【0004】

有機EL素子における有機発光層の形成方法としては、低分子発光材料を蒸着法で形成する方法（特開昭59-194393号公報参照）と、高分子発光材料又はその前駆体を塗布する方法（特開平3-244630号公報、特開平10-92577号公報参照）が主に行われているが、有機EL素子の製造工程が簡便で、低コスト化が可能となる後者の方法が注目されている。

## 【0005】

また、上記有機発光層の形成に用いる高分子発光材料としては、溶媒に可溶な前駆体の塗布・乾燥・高温加熱処理による重合反応で得られる共役系高分子のポリ（p-フェニレンビニレン）（以下、PPVとも記す）（特開平10-92577号公報参照）、溶媒に可溶で高温加熱処理が不要な共役系高分子（特開平3-244630号公報参照）等が提案されている。

## 【0006】

更に、有機EL素子においては、発光効率並びに耐久性を向上させるために、例えばポリチオフェン誘導体等の導電性高分子からなる正孔注入層（ホール注入層）を、陽極と発光層の間に形成することが提案されている（特表2000-514590号公報参照）。

## 【0007】

上記有機EL素子を構成する各層のうち、有機発光層や正孔注入層（ホール注入層）は、それぞれ高分子発光材料や導電性高分子を塗布・乾燥して形成する塗布法が適用されている。一方、アノード電極に用いられる透明導電膜は、インジウム錫酸化物（ITO）、錫アンチモン酸化物（ATO）等の導電性酸化物からなり、スパッタリング等の物理的方法で形成されている。しかし、この物理的方法で透明導電膜を得る方法は、大型の装置を必要とし、更に真空中において膜形成する必要があるため、コスト面から見て好ましいとは言えず、更には膜形成時に基板加熱が必要なため、耐熱性の乏しいプラスチック基板への膜形成ができない等の制約もあった。

## 【0008】

そこで、より簡便で且つ低温成膜可能な透明導電膜の形成方法として、溶媒に導電性微粒子を分散させた透明導電膜形成用塗布液を塗布・乾燥し、必要に応じて加熱処理する方法が提案されている。特に、導電性微粒子として金や銀等の貴金属含有微粒子を用いる透明導電膜形成用塗布液（例えば、特開2000-268639号公報参照）を用いて形成

した透明導電膜は、抵抗値や透過率等の膜特性が優れている点で好ましい。

【0009】

しかしながら、上記透明導電膜形成用塗布液を用いて塗布法により形成した透明導電膜は、前述の有機EL素子のアノード電極に適用した場合、以下の問題があった。即ち、塗布法により得られる透明導電アノード電極は、前述の物理的方法で得られた透明導電アノード電極に比べて必然的に表面の凹凸が大きくなるうえ、更には塗布液の塗布・乾燥工程において導電性微粒子の凝集により粗大粒子や塗布ムラ等が発生するため、これらの塗布欠陥に起因した著しい突起部の形成が避けられなかった。

【0010】

この透明導電アノード電極層の凹凸ないし突起部が著しく大きくなると、有機EL素子の透明導電アノード電極層とカソード電極層の間で電氣的短絡（ショート）が発生し、有機EL素子が発光しなかったり、発光効率が著しく低下したりする等の問題が生じていた。そのため、有機EL素子の透明導電アノード電極層として、塗布法で形成された透明導電膜を適用することは困難であった。

【0011】

【特許文献1】特開昭59-194393号公報

【特許文献2】特開平03-244630号公報

【特許文献3】特開平10-092577号公報

【特許文献4】特表2000-514590号公報

【特許文献5】特開2000-268639号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたものであり、簡便且つ低コストで、低温成膜可能な塗布法により形成された透明導電膜を透明導電アノード電極層としながら、透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に電氣的短絡（ショート）を生じない有機EL素子、その有機EL素子の製造に用いられる透明導電積層体、及びその製造方法を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明が提供する請求項1の透明導電積層体は、平滑な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層と、該透明導電アノード電極層に接着剤層により接合された透明基材とを備え、前記平滑な基板が透明導電アノード電極層から剥離可能であることを特徴とする。

【0014】

本発明の請求項2の透明導電積層体は、平滑な基板と、該平滑な基板上に塗布法により形成されたホール注入層と、該ホール注入層上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層と、該透明導電アノード電極層に接着剤層により接合された透明基材とを備え、前記平滑な基板がホール注入層から剥離可能であることを特徴とする。

【0015】

本発明の請求項4の透明導電積層体は、上記請求項1～3の透明導電積層体において、前記透明導電アノード電極層が、平均粒径1～100nmの貴金属含有微粒子で構成された網目状構造を有することを特徴とする。また、本発明の請求項5の透明導電積層体は、上記請求項4の透明導電積層体において、前記貴金属含有微粒子が、金又は銀の微粒子若しくは金と銀を含有する微粒子であることを特徴とするものである。

【0016】

本発明が提供する請求項6の透明導電積層体の製造方法は、平滑な基板上に、溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電アノード電極層形成用塗布液を塗布・乾燥させて透明導電アノード電極層を形成すると共に、該平滑な基板として透明導電アノード電極層から剥離可能な基板を用い、得られた透明導電アノード電極層上に接着剤を用いて透明基材を

接合することを特徴とする。

【0017】

本発明の請求項 7 の透明導電積層体の製造方法は、前記平滑な基板上に、溶媒中にホール注入性物質を含むホール注入層形成用塗布液を塗布・乾燥させてホール注入層を形成すると共に、該平滑な基板としてホール注入層から剥離可能な基板を用い、該ホール注入層上に透明導電アノード電極層を形成し、得られた透明導電アノード電極層上に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする。

【0018】

本発明の請求項 8 の透明導電積層体の製造方法は、上記請求項 6 又は 7 の透明導電積層体において、前記透明導電アノード電極層上に、溶媒とバインダーを主成分とする透明コート層形成用塗布液を塗布・乾燥させて透明コート層を形成し、該透明コート層に接着剤を用いて透明基材を接合することを特徴とする。

【0019】

本発明の請求項 9 の透明導電積層体の製造方法は、上記請求項 6～8 の透明導電積層体において、前記透明導電アノード電極層形成用塗布液の導電性微粒子が、平均粒径 1～100 nm の貴金属含有微粒子であることを特徴とする。また、本発明の請求項 10 の透明導電積層体の製造方法は、上記請求項 9 の透明導電積層体において、前記貴金属含有微粒子が、金又は銀の微粒子若しくは金と銀を含有する微粒子であることを特徴とする。

【0020】

また、本発明が提供する請求項 11 の有機 EL 素子は、上記請求項 1～5 のいずれかの透明導電積層体から平滑な基板を剥離した透明導電アノード電極層又はホール注入層の剥離面上に、塗布法により形成されたポリマー発光層と、該ポリマー発光層上に設けたカソード電極層とを備えることを特徴とする。

【0021】

更に、本発明が提供する請求項 12 の有機 EL 素子の製造方法は、上記請求項 6～10 の製造方法で得られた透明導電積層体から平滑な基板を剥離除去した後、透明導電アノード電極層又はホール注入層の剥離面上に、溶媒と高分子発光材料又はその前駆体を含むポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥してポリマー発光層を形成し、該ポリマー発光層上にカソード電極層を形成することを特徴とする。

【発明の効果】

【0022】

本発明の透明導電積層体においては、平滑な基板上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層は、他方の面が透明基材に接着層を介して接合されている。そして、平滑な基板が剥離除去可能であるため、平滑な基板を剥離した透明導電アノード電極層の剥離面は十分に平滑となると共に、透明導電アノード電極層自体は透明基材で支持されている。従って、透明導電積層体から平滑な基板を剥離した状態の透明導電アノード電極層の平滑な剥離面上には、凹凸や突起部のないポリマー発光層やカソード電極層を容易に形成することができるため、有機 EL 素子の構成部分の一部として用いることができる。

【0023】

本発明の有機 EL 素子は、塗布法により形成された透明導電アノード電極層を有するにもかかわらず、その透明導電アノード電極層のカソード電極層側に凹凸や突起部が発生することがないため、カソード電極層との間で電氣的短絡を生じることがない。従って、透明導電アノード電極層を塗布法により形成できるため、簡便且つ低コストで、低温成膜が可能であり、ポリマー発光層の劣化を起こしにくく、液晶バックライト等の光源やディスプレイ等の表示装置に適用可能な有機 EL 素子を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

従来の塗布法により形成された透明導電アノード電極層を備える有機 EL 素子は、図 3 に示すように、透明基材 4 上に透明導電層形成用塗布液を塗布・乾燥して透明導電アノード電極層 2 を形成し、その上にポリマー発光層 6 とカソード電極層 7 を積層して製造され

ていた。そのため、塗布欠陥等によって透明導電アノード電極層 2 に大きな突起部 9 が発生した場合、カソード電極層 7 との間で電氣的短絡（ショート）が発生しやすくなり、有機 EL 素子が発光しなくなったり、発光効率が著しく低下したりし易く、またポリマー発光層 6 の絶縁破壊が起き易かった。

#### 【0025】

そこで、本発明では、下記する転写法の応用により上記の問題点を解決した。即ち、図 1 に示すように、まず、有機 EL 素子の構成に用いない平滑な基板 1 上に、透明導電アノード電極層形成用塗布液を塗布・乾燥して透明導電アノード電極層 2 を形成し、得られた透明導電アノード電極層 2 の平滑な基板 1 との反対面に、有機 EL 素子の構成に用いる透明基材 4 を接着剤で貼り合わせた後、接着剤を硬化させて接合する。

#### 【0026】

このようにして得られる本発明の透明導電積層体の基本的な構造は、図 1 に示すように、透明導電アノード電極層 2 を成膜するための仮の基板として用いた平滑な基板 1 と、平滑な基板 1 上に塗布法により形成された透明導電アノード電極層 2 と、その透明導電アノード電極層 2 に接着剤層 3 で接合された透明基材 4 とを備え、この平滑な基板 1 は透明導電アノード電極層 2 から剥離することが可能である。

#### 【0027】

次に、この透明導電積層体から、平滑な基板 1 を剥離して除去すると、平滑な基板 1 の剥離除去により露出した透明導電アノード電極層 2 の剥離面は、平滑な基板 1 を反映した平滑な面となる。その後、図 2 に示すように、この透明導電アノード電極層 2 の平滑な剥離面上に、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥してポリマー発光層 6 を形成し、更に、そのポリマー発光層 6 の上にカソード電極層 7 を形成することにより、本発明の有機 EL 素子を得ることができる。

#### 【0028】

図 2 に示す基本的構造の有機 EL 素子は、透明基材 4、接着剤層 3、塗布法で形成された透明導電アノード電極層 2、ポリマー発光層 6、及びカソード電極層 7 で構成されている。この本発明の有機 EL 素子では、透明導電アノード電極層 2 に導電性微粒子の凝集による粗大粒子、塗布ムラ、異物等の塗布欠陥に起因した突起部 9 が発生した場合であっても、その突起部 9 は接着剤層 3 の側に突き出し、反対側のポリマー発光層 6 と透明導電アノード電極層 2 の界面には全く影響を及ぼさない。従って、カソード電極層 7 との間での電氣的短絡（ショート）の発生、及びポリマー発光層 6 の絶縁破壊の発生等を、効果的に抑制することができる。

#### 【0029】

尚、上記した本発明の透明導電積層体は、そのままの形で保管することが可能であり、有機 EL 素子を製造するに際して、ポリマー発光層を形成する直前に平滑な基板を剥離除去すれば良いため、剥離面への異物やホコリ等の付着を効果的に防止できる利点もある。

#### 【0030】

また、有機 EL 素子の発光効率及び耐久性を向上させるために、導電性高分子からなるホール注入層を設けることもできる。例えば、図 4 に示すように、上記した透明導電積層体の製造に際して、平滑な基板 1 上に、透明導電アノード電極層 2 の形成に先立って、ホール注入層形成用塗布液を塗布・乾燥させてホール注入層 5 を形成し、その後、このホール注入層 5 上に透明導電アノード電極層 2 を上記と同様に塗布法により形成する。

#### 【0031】

この透明導電積層体を用いて有機 EL 素子を製造する場合は、図 5 に示すように、上記と同様に平滑な基板 1 を剥離除去する。その後、図 6 に示すように、平滑な基板 1 を剥離除去して露出したホール注入層 5 の平滑な剥離面上に、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥してポリマー発光層 6 を形成し、更に、そのポリマー発光層 6 上にカソード電極層 7 を形成する。

#### 【0032】

また、本発明の透明導電積層体及び有機 EL 素子には、透明導電アノード電極層と接着



剤層の間に、塗布法により形成された透明コート層を備えることができる。まず、透明導電積層体の製造に際しては、図7に示すように、平滑な基板1上に、必要に応じてホール注入層5、透明導電アノード電極層2を形成した後、この透明導電アノード電極層2上に透明コート層形成用塗布液を塗布・乾燥して透明コート層8を形成する。その後、この透明コート層8の平滑な基板1との反対面に、接着剤を用いて透明基材4を接合する。

#### 【0033】

この透明導電積層体を用いて有機EL素子を製造する場合も、上記と同様に平滑な基板1を剥離除去する。その後、図8に示すように、平滑な基板1を剥離除去した後のホール注入層5の平滑な剥離面上に、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥してポリマー発光層6を形成し、更に、そのポリマー発光層6上にカソード電極層7を形成することにより、有機EL素子が得られる。

#### 【0034】

このように、透明導電アノード電極層2上に透明コート層形成用塗布液をオーバーコートすると、透明コート層形成用塗布液中のバインダー成分が透明導電アノード電極層2の導電性微粒子間の空隙にしみ込み、導電性微粒子同士の接触を強化することができる。その結果、透明導電アノード電極層2の導電性を向上させ、同時に透明導電アノード電極層2自体の強度を向上させることができる。

#### 【0035】

上記において、本発明の透明導電積層体は、ポリマー発光層形成用塗布液で形成された発光層を有する有機EL素子に適用できることを示したが、もちろん前述の低分子発光材料の蒸着等で形成される発光層を有する有機EL素子に適用した場合においても、同様に電極間ショートや発光層の絶縁破壊等を効果的に抑制することができる。

#### 【0036】

本発明の有機EL素子の構造については、上記以外にも、例えば、ホール注入層5とポリマー発光層6の間にホール輸送層を設けても良いし、ホール注入層5としてホール輸送層を兼ねたホール注入輸送層を用いても良い。また、カソード電極層7とポリマー発光層6の間に、電子輸送層を設けても良い。これらホール輸送層や電子輸送層を設けると、ポリマー発光層6に注入されたキャリアである正孔（ホール）と電子とが効率よく再結合できるため、より発光効率を高めることができる。

#### 【0037】

更に、有機EL素子は、その用途に応じて、透明導電アノード電極層を所定のパターンに形成する場合がある。例えば、図9に示すように、本発明の有機EL素子において、透明導電アノード電極層2を印刷等により所定のパターンに塗布・乾燥して形成した場合、その透明導電アノード電極層2は塗布法によりホール注入層6上に形成されるので、透明導電アノード電極層2のパターンが形成された部分と形成されていない部分がなす凹凸は、必ずホール注入層6と反対側、即ち接着剤層3側に存在することになる。そして、透明導電アノード電極層2とホール注入層5との界面は凹凸のない平滑な面となるため、透明導電アノード電極層2のパターニングがホール注入層5やポリマー発光層6の膜厚均一性に影響を及ぼすことがない。

#### 【0038】

一方、従来の有機EL素子の製造方法においては、図10に示すように、透明基材4上に透明導電アノード電極層2やホール注入層5などを順次形成していくので、塗布法で形成されたか又はスパッタリング等の物理的方法で形成されたかにかかわらず、パターン形成された透明導電アノード電極層2の凹凸は透明基材4と反対側に現れる。特に透明導電アノード電極層が塗布法で形成された場合には、エッジ部分の形状がシャープでなく、だれた傾斜面になるため、透明導電アノード電極層の凹凸の差はますます大きくなる。

#### 【0039】

そのため、従来法で得られた有機EL素子では、上記のごとく表面が凹凸な透明導電アノード電極層2上にホール注入層5やポリマー発光層6が形成されるため、膜厚の不均一が生じることになり、電極間ショート、ポリマー発光層6の絶縁破壊、発光輝度ムラ等が

起き易くなる。尚、図10では、便宜的に、ホール注入層5、ポリマー発光層6、カソード電極層7の間の各界面が平坦なように描かれているが、実際には、上記したようにパターン形成された透明導電アノード電極層2の影響を受けるため凹凸が生じ、ホール注入層5やポリマー発光層6には膜厚の不均一が生じている。

#### 【0040】

上記した透明導電アノード電極層2、ホール注入層5、ポリマー発光層6、及び透明コート層8の形成は、塗布法によって行うことができる。即ち、透明導電アノード電極層形成用塗布液、ホール注入層形成用塗布液、ポリマー発光層形成用塗布液、あるいは透明コート層形成用塗布液を、スピンコート、スプレーコート、ドクターブレードコート、ロールコート、グラビア印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷等の手法により塗布・乾燥し、必要に応じて、例えば50～200℃程度の温度で加熱処理を施すことにより、上記各層を形成することができる。

#### 【0041】

本発明で用いる平滑な基板は、透明導電アノード電極層又はホール注入層との界面で剥離可能であれば、特に限定されるものではない。具体的には、ガラス、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリエーテルサルフォン（PES）等のプラスチック、ステンレス等の金属を用いることができる。なかでも、安価で且つ表面の平坦度が高く、フレキシブルで剥離しやすい等の観点から、PETフィルムが好ましい。

#### 【0042】

平滑な基板と透明導電アノード電極層又はホール注入層との間での剥離性は、平滑な基板の材質、透明導電アノード電極層形成用塗布液又はホール注入層形成用塗布液の成分により、更には接着剤の種類や透明コート層形成用塗布液の成分（接着剤や透明コート層形成用塗布液は、透明導電アノード電極層内にしみ込んだ場合や、透明導電アノード電極層をパターン形成した場合には、平滑な基板の表面に達する場合があるため）により影響を受ける。しかし、平滑な基板がガラス、プラスチック、又は金属で且つその表面が通常の平滑面であれば、塗布法で形成される透明導電アノード電極層又はホール注入層との界面で、容易に剥離可能な状態とすることができる。

#### 【0043】

一方、透明基材は、従来から有機EL素子に使用されているものでよく、例えば、可視光線を透過するポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリエーテルサルフォン（PES）等のプラスチックのフィルム又は板、あるいはガラス板等を用いることができる。プラスチックを透明基材として用いるときは、有機EL素子の水分による劣化防止のため、予め防湿コーティングを施しておくことが好ましい。また、透明基材には、接着剤との密着力を高める易接着処理、具体的には、プライマー処理、プラズマ処理、コロナ放電処理、短波長紫外線照射処理、シリコンカップリング処理等を予め施すことが好ましい。

#### 【0044】

接着剤としては、アクリル系、ウレタン系、エポキシ系等の常温硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂など、各種のものを用いることができるが、少なくとも平滑な基板の剥離の際に透明導電アノード電極層又は透明コート層を透明基材に接着しておくことができ、しかも平滑な基板の剥離性に悪影響を及ぼさない限り、これらに限定されない。

#### 【0045】

接着剤による透明基材の貼り合わせは、平滑な基板上に形成された透明導電アノード電極層又は透明コート層の上、あるいは透明基材の上、若しくはその両方に接着剤を塗布し、必要に応じて乾燥した後、一般的にはスチールロール又はゴムロール等を用いて0.1～2.94×10<sup>3</sup> N/m程度の線圧力を掛けながら行う。尚、接着剤の塗布は、スピンコート、スプレーコート、ドクターブレードコート、ロールコート、グラビア印刷、スクリーン印刷等の汎用の方法が適用できる。上記貼り合せを行った後、接着剤を硬化させて

接合が完了する。接着剤の硬化は、熱硬化性樹脂を用いた場合は加熱により行うが、紫外線硬化樹脂を用いた場合には、平滑な基板側又は透明基材側から紫外線照射を行うため、平滑な基板又は透明基材のいずれか一方は、紫外線を透過する材質のものでなければならない。

#### 【0046】

次に、本発明で用いる透明導電アノード電極層形成用塗布液は、溶媒と、その溶媒中に分散された導電性微粒子とを主成分とする。導電性微粒子としては、微粒状及び／又は針状のインジウム錫酸化物（ITO）微粒子、錫アンチモン酸化物（ATO）微粒子等の導電性酸化物微粒子、または平均粒径1～100nmの貴金属含有微粒子を適用することができる。

#### 【0047】

中でも貴金属含有微粒子を用いた透明導電アノード電極層形成用塗布液は、得られる膜の透過率が幾分低下するものの、膜抵抗値を低くすることが可能となるため、透明導電アノード電極層の導電性を優先する場合には好適である。上記貴金属含有微粒子の平均粒径を1～100nm、好ましくは3～20nmとする理由は、1nm未満だと透明導電層形成用塗布液の製造が困難となり、100nmを超えると透明導電アノード電極層において高透過率と低抵抗値を同時に達成することが困難になるからである。

#### 【0048】

上記貴金属含有微粒子としては、金又は銀の微粒子や、金と銀を含有する微粒子が好ましい。その理由は、銀、金、白金、ロジウム、ルテニウム、パラジウムなどの比抵抗を比較した場合、白金、ロジウム、ルテニウム、パラジウムの比抵抗は、それぞれ10.6、4.51、7.6、10.8 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ であり、銀及び金の1.62、2.2 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ に比べて高いため、表面抵抗の低い透明導電アノード電極層を形成するには、銀や金の微粒子又は金と銀を含む微粒子を適用した方が有利と考えられるからである。

#### 【0049】

更に、銀微粒子が単独で適用された場合、酸化・硫化等による劣化や、紫外線による劣化が激しく、耐候性の面で制約がある。他方、金微粒子が単独で適用された場合には、上記耐候性の問題はないが、コスト面で不利である。そのため、金及び銀を含有する微粒子の適用が更に望ましい。

#### 【0050】

金及び銀を含有する微粒子としては、銀微粒子の表面に金をコーティングした金コート銀微粒子を用いることが好ましい。例えば、特開平2000-268639号公報には、表面に金がコーティングされた平均粒径1～100nmの貴金属コート銀微粒子を適用した透明導電層形成用塗布液、並びにその製造方法が開示されている。金コート銀微粒子における金のコーティング量は、上記耐候性を考慮すれば、銀100重量部に対し100～1900重量部の範囲に設定することが好ましい。

#### 【0051】

ところで、貴金属含有微粒子は可視光線に対し本来的に透明でないことから、貴金属含有微粒子が適用された透明導電アノード電極層において、高透過率と低抵抗を両立させるためには、できるだけ少量の貴金属含有微粒子が効率よく導電パスを形成していることが望ましい。つまり、透明導電アノード電極層形成用塗布液を塗布して得られた透明導電アノード電極層は、貴金属含有微粒子の導電層に微小な空孔が導入された構造、即ち網目状構造を有することが好ましい。このような網目状構造が形成されると、貴金属含有微粒子からなる網目状部分が導電パスとして機能する一方、網目状構造に形成された穴の部分が光透過率を向上させる機能を果たすため、低抵抗で且つ高透過率の透明導電アノード電極層が得られるものと考えられている。

#### 【0052】

上記貴金属含有微粒子の網目状構造を形成させるためには、予め連鎖状に凝集した貴金属含有微粒子（貴金属含有微粒子の連鎖状凝集体）が分散した透明導電膜形成用塗布液を用い、これを塗布・乾燥させることによって透明導電アノード電極層を形成することが望

ましい。上記連鎖状凝集体の平均主鎖長さは20～500 nmが好ましく、30～300 nmが更に好ましい。平均主鎖長さが20 nm未満では得られる透明導電アノード電極層の抵抗が高くなり、500 nmを超えると透明導電アノード電極層形成用塗布液の濾過が困難になると同時に、透明導電アノード電極層形成用塗布液の保存安定性が悪化するからである。

#### 【0053】

また、上記連鎖状凝集体の平均主鎖長さと貴金属含有微粒子の平均粒径（連鎖状凝集体の平均太さ）の比は、3～100の範囲にあることが好ましい。この範囲を外れると、上記と同様に、良好な導電性を有する透明導電アノード電極層の形成が難しくなったり、透明導電アノード電極層形成用塗布液の濾過が困難になると同時に、透明導電アノード電極層形成用塗布液の保存安定性が悪化することがあるからである。尚、上記した連鎖状凝集体の平均主鎖長さと貴金属含有微粒子の平均粒径は、透過電子顕微鏡（TEM）で観察された凝集体に対する値を示している。

#### 【0054】

透明導電アノード電極層形成用塗布液には、少量のバインダーを添加してもよい。バインダーを添加した透明導電アノード電極層形成用塗布液を用いると、単層で、膜強度の高い透明導電アノード電極層を得ることができる。バインダーとしては、有機及び／又は無機バインダーを用いることが可能であり、適用する平滑な基板、ホール注入層の材質、透明導電アノード電極層の膜形成条件等を考慮して、適宜選定することができる。

#### 【0055】

上記有機バインダーとしては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、常温硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂等から選定することができる。例えば、熱可塑性樹脂としては、アクリル樹脂、PET樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、PVP樹脂、ポリビニルアルコール樹脂などがあり、熱硬化性樹脂としてはエポキシ樹脂など、常温硬化性樹脂としては2液性のエポキシ樹脂やウレタン樹脂など、紫外線硬化性樹脂としては各種オリゴマー、モノマー、光開始剤を含有する樹脂など、電子線硬化性樹脂としては各種オリゴマー、モノマーを含有する樹脂などを挙げることができるが、これら樹脂に限定されるものではない。

#### 【0056】

また、無機バインダーとしては、シリカゾルを主成分とするバインダーを挙げることができる。無機バインダーは、弗化マグネシウム微粒子、アルミナゾル、ジルコニアゾル、チタニアゾル等や、一部有機官能基で修飾されたシリカゾルを含んでいてもよい。上記シリカゾルとしては、オルトアルキルシリケートに水や酸触媒を加えて加水分解し、脱水縮重合を進ませた重合物、あるいは既に4～5量体まで重合を進ませた市販のアルキルシリケート溶液を、更に加水分解と脱水縮重合を進行させた重合物等を利用することができる。

#### 【0057】

尚、脱水縮重合が進行し過ぎると、溶液粘度が上昇して最終的には固化してしまうので、脱水縮重合の度合いについては、ガラス基板やプラスチック基板などの透明基板上に塗布可能な上限粘度以下に調整する。ただし、脱水縮重合の度合いは上記上限粘度以下のレベルであれば特に限定されないが、膜強度、耐候性等を考慮すると、重量平均分子量で500～5000程度が好ましい。そして、このアルキルシリケート加水分解重合物（シリカゾル）は、透明導電アノード電極層形成用塗布液の塗布・乾燥後の加熱時において脱水縮重合反応がほぼ完結し、硬いシリケート膜（酸化ケイ素を主成分とする膜）になる。

#### 【0058】

ホール注入層形成用塗布液は、溶媒とホール注入性物質とを含んでいる。ホール注入性物質としては、ポリシラン、ポリアニリン、ポリチオフェン、これらの誘導体、例えば、ポリ（3,4-エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸の混合物（PEDOT/PSS）（バイエル社製、商品名バイترون）等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

## 【0059】

ポリマー発光層形成用塗布液は、溶媒と高分子発光材料又は高分子発光材料の前駆体とを含んでいる。高分子発光材料を用いる場合は、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥するだけで、簡単にポリマー発光層を形成することができる。高分子発光材料としては、例えば、ポリ-p-フェニレンビニレン (PPV) 系、ポリフェニレン系、ポリフルオレン系、ポリビニルカルバゾール系等の高分子、これらに低分子蛍光色素（例えば、クマリン、ペリレン、ローダミン、又はそれらの誘導体）を加えたもの等があるが、溶媒に溶解し且つ塗布形成できるものであれば良く、これらに限定されない。

## 【0060】

また、高分子発光材料の前駆体を用いる場合は、ポリマー発光層形成用塗布液を塗布・乾燥した後、200℃程度の高温加熱処理を行い、前駆体を重合させて高分子化発光材料に転換させる必要がある。一般によく用いられる高分子発光材料の前駆体としては、高分子発光材料であるポリ-p-フェニレンビニレン (PPV) の前駆体が挙げられるが、これに限定されるものではない。

## 【0061】

透明コート層形成用塗布液は、溶媒とバインダーとで構成される。バインダーとしては、前述の透明導電アノード電極層形成用塗布液に添加するバインダーと同様のものであってよく、有機及び／又は無機バインダーを用いることができ、中でもシリカゾルを主成分とするバインダーが好ましい。

## 【0062】

カソード電極層としては、ポリマー発光層への電子注入性の観点から、仕事関数の低い金属、例えば、リチウム (Li)、K (カリウム)、Na (ナトリウム) 等のアルカリ金属、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca) 等のアルカリ土類金属、アルミニウム (Al) 等が好ましい。カソード電極層の安定性を考慮して、上記金属と、インジウム (In)、銀 (Ag) 等の安定性の良い金属とを、併用し又は積層して用いることが好ましい。

## 【0063】

上記カソード電極層の形成は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の公知の方法を用いて行うことができる。また、カソード電極層とポリマー発光層との間に、フッ化リチウム (LiF) やフッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) 等からなる厚さ数 nm 程度の薄膜を挟みこんだ構造も、電子注入性を高めることができるので好ましい。

## 【0064】

次に、本発明で用いる透明導電アノード電極層形成用塗布液の製造方法を、導電性微粒子が金コート銀微粒子である場合を例にとりて説明する。まず、既知の方法 [例えば、Carey-Lea 法: Am. J. Sci., 37, 38, 47 (1889) 参照] により、単分散銀微粒子のコロイド分散液を調製する。具体的には、硝酸銀水溶液に硫酸鉄 (II) 水溶液とクエン酸ナトリウム水溶液の混合液を加えて反応させ、沈降物を濾過・洗浄した後、純水を加えることによって、単分散銀微粒子のコロイド分散液が得られる。

## 【0065】

この銀微粒子コロイド分散液に、ヒドラジン等の還元剤溶液と、金酸塩溶液を加えることにより、銀微粒子表面に金がコーティングされた金コート銀微粒子の分散液が得られる。尚、必要に応じて、上記金コーティング工程において、銀微粒子のコロイド分散液又は金酸塩溶液のいずれか片方若しくは両方に、少量の分散剤を添加しても良い。

## 【0066】

その後、透析、電気透析、イオン交換、限外濾過等の方法で、分散液内の電解質濃度を下げることが好ましい。電解質濃度を下げないと、一般にコロイドは電解質で凝集してしまうからであり、この現象は Schulze-Hardy 則として知られている。このように電解質濃度を下げた金コート銀微粒子分散液は、減圧エバポレーター、限外濾過等の方法で濃縮処理して、単分散金コート銀微粒子の分散濃縮液とする。この濃縮度合いによって、最終的な透明導電アノード電極層形成用塗布液中の水分濃度を、好ましくは 1~5

0重量%の範囲に制御することができる。

【0067】

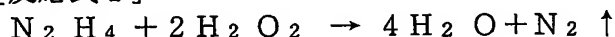
この単分散金コート銀微粒子の分散濃縮液を攪拌しながら、ヒドラジン溶液を少量ずつ添加し、例えば室温で数分から数時間程度保持することにより、金コート銀微粒子を連鎖状に凝集させる。その後、過酸化水素溶液を添加してヒドラジンを分解することで、連鎖状凝集金コート銀微粒子分散（濃縮）液が得られる。ヒドラジン溶液の添加により金コート銀微粒子に連鎖状の凝集が生じる理由は明らかではないが、ヒドラジンのアルカリイオンとしての働き、あるいは還元剤として系の電位を低下させる働きにより、金銀含有微粒子の安定性が低下して連鎖状に凝集するものと考えられる。

【0068】

尚、上記した凝集過程において、金コート銀微粒子の分散濃縮液にヒドラジン（ $N_2H_4$ ）溶液を添加すると金コート銀微粒子の安定性が低下（系のゼータ電位〔絶対値〕は低下）して連鎖状に凝集し、更に過酸化水素（ $H_2O_2$ ）溶液を添加すると上記ヒドラジンが分解除去され、連鎖状金コート銀微粒子の凝集状態は保ったままで、その安定性が再度向上（系のゼータ電位〔絶対値〕は増加）する。しかも、これら一連の反応は、下記反応式1に示されるように、反応生成物が水（ $H_2O$ ）及び窒素ガス（ $N_2$ ）だけで不純物イオンの副生がないため、金コート銀微粒子の連鎖状凝集体を得る方法としては極めて簡便で有効な方法である。

【0069】

〔反応式1〕



【0070】

上記連鎖状凝集金コート銀微粒子における直鎖や分岐などの凝集形態の制御に関しては、現時点では系統だった解析はまだ行われていないが、金コート銀微粒子濃度、ヒドラジン溶液濃度、ヒドラジン溶液添加速度、処理液の攪拌速度、処理液の温度等を調整することにより、凝集形態の制御が可能である。

【0071】

得られた連鎖状凝集金コート銀微粒子分散（濃縮）液に有機溶剤等を添加し、導電性微粒子濃度、水分濃度、高沸点有機溶剤濃度等の成分調整を行うことにより、連鎖状凝集金コート銀微粒子を含有する透明導電アノード電極層形成用塗布液が得られる。ここで、透明導電アノード電極層形成用塗布液中の連鎖状凝集金コート銀微粒子量は0.1～10重量%、水分は1～50重量%、有機溶剤その他添加物が残部となるように成分調整することが好ましい。

【0072】

連鎖状凝集金コート銀微粒子が0.1重量%を未満では、透明導電アノード電極層に十分な導電性能が得られず、5重量%を超えると連鎖状凝集金コート銀微粒子が不安定になり凝集しやすくなる。また、水分濃度が1重量%よりも少ない場合、つまり金コート銀微粒子分散（濃縮）液の濃縮度を高めた場合は、前述と同様に連鎖状凝集金コート銀微粒子の濃度が高くなり過ぎるため、連鎖状凝集金コート銀微粒子が不安定になり凝集しやすくなる。逆に、水分濃度が50重量%を超えると、透明導電アノード電極層形成用塗布液の塗布性が著しく悪化する可能性がある。

【0073】

透明導電アノード電極層形成用塗布液に用いる有機溶媒としては、特に制限はなく、塗布方法や製膜条件により適宜に選定することができる。例えば、メタノール（MA）、エタノール（EA）、1-プロパノール（NPA）、イソプロパノール（IPA）、ブタノール、ペンタノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコール（DAA）等のアルコール系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン（MEK）、メチルプロピルケトン、メチルイソブチルケトン（MIBK）、シクロヘキサノン、イソホロン等のケトン系溶媒、エチレングリコールモノメチルエーテル（MCS）、エチレングリコールモノエチルエーテル（ECS）、エチレングリコールイソプロピルエーテル（IPC）、プロピレングリコー



ルメチルエーテル (PGM)、プロピレングリコールエチルエーテル (PE)、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート (PGM-AC)、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート (PE-AC) 等のグリコール誘導体、ホルムアミド (FA)、N-メチルホルムアミド、ジメチルホルムアミド (DMF)、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルフォキシド (DMSO)、N-メチル-2-ピロリドン (NMP)、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン (THF)、クロロホルム、メシチレン、ドデシルベンゼン等のベンゼン誘導体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

#### 【0074】

ホール注入層形成用塗布液、透明コート層形成用塗布液、ポリマー発光層形成用塗布液についても、ホール注入性物質、バインダー、高分子発光材料の溶解性あるいは分散性を損なわない範囲内で、上記した溶媒を用いることができる。

#### 【0075】

上記に説明したように、本発明の透明導電積層体では、平滑な基板上に塗布法により形成された少なくとも透明導電アノード電極層を有する層が、同時に反対面で透明基材に接着剤層を介して接合されており、且つ透明導電積層体から平滑な基板を剥離除去することが可能である。従って、平滑な基板を剥離除去した透明導電積層体の剥離面は平滑であるから、その剥離面上にポリマー発光層等を更に形成することによって、高分子発光材料を用いるタイプの有機EL素子の部材として適用することができる。

#### 【0076】

また、本発明の有機EL素子は、簡便な塗布法により形成された透明導電アノード電極層を有するにもかかわらず、その透明導電アノード電極層のカソード電極層側に凹凸や突起部が存在しないため、透明導電アノード電極層とカソード電極層との間で電氣的短絡を生じることがない。従って、簡便で低温成膜可能な塗布法により製造でき、安価であると共に、ポリマー発光層の劣化を起こし難い有機EL素子を提供することができ、液晶バックライト等の光源やディスプレイ等の表示装置に適用することができる。

#### 【実施例】

##### 【0077】

以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の記述において「%」は、透過率、ヘイズ値の%を除いて、「重量%」を示している。

##### 【0078】

##### 【実施例1】

前述の方法に従って、まずCarey-Lea法により銀微粒子のコロイド分散液を調製し、銀微粒子表面への金のコーティング、脱塩処理、凝集処理、濃縮処理、成分調整等を行って、金コート銀微粒子を含む透明導電アノード電極層形成用塗布液を得た。

##### 【0079】

この透明導電アノード電極層形成用塗布液の組成は、AuコートAg微粒子 (Ag/Au重量比=1/4) : 0.5%、水: 10.6%、エタノール (EA) : 63.85%、プロピレングリコールメチルエーテル (PGM) : 15.0%、ジアセトンアルコール (DAA) : 10.0%、ホルムアミド (FA) : 0.05%であった。

##### 【0080】

また、この透明導電アノード電極層形成用塗布液を透過電子顕微鏡で観察したところ、AuコートAg微粒子は、一次粒径6.5nm程度のAuコートAg微粒子が連鎖状に連なり、且つ一部分岐した連鎖状凝集体を形成していた。その連鎖状凝集体の主鎖長さ (個々の連鎖状凝集金コート銀微粒子における主鎖長さの最大値) は100~500nmであった。

##### 【0081】

平滑な基板として、PETフィルム (帝人 (株) 製、厚さ100 $\mu$ m) を使用した。この平滑な基板を40℃に予熱した後、上記透明導電アノード電極層形成用塗布液をスピン

コーティング（130rpm、100秒間）し、120℃にて10分間加熱処理して、平滑な基板上に透明導電アノード電極層を形成した。この透明導電アノード電極層の膜特性は、可視光透過率＝77%、ヘイズ値＝0.1%、表面抵抗値＝140Ω/□であった。

#### 【0082】

得られた透明導電アノード電極層上に、アクリル系紫外線硬化性接着剤を塗布し、透明基材としてのガラス基板（ソーダライムガラス、厚さ1mm）に貼り合わせた後、高圧水銀ランプを用いて接着剤を硬化させて、平滑な基板／透明導電アノード電極層／接着剤層／透明基材からなる実施例1に係る透明導電積層体を得た。この透明導電積層体において、平滑な基板としてのPETフィルムは、透明導電アノード電極層との界面で簡単に剥離することができた。

#### 【0083】

上記透明導電積層体の平滑な基板（PETフィルム）を剥離して得られた透明導電アノード電極層の平滑な剥離面上に、透明基材を40℃に予熱した後、ポリマー発光層形成用塗布液をスピンコーティング（150rpm、60秒間）し、80℃で60分間真空加熱処理してポリマー発光層を形成した。使用した上記ポリマー発光層形成用塗布液の組成は、ポリ〔2-メトキシ-5-（3', 7'-ジメチルオクチロキシ）-1, 4-フェニレンビニレン〕：0.25%、トルエン：99.75%であった。

#### 【0084】

このポリマー発光層上に、カルシウム（Ca）、銀（Ag）の順番で真空蒸着を行い、CaとAgからなる2層のカソード電極層（サイズ：1cm×1.5cm）を形成して、実施例1に係る有機EL素子を得た。得られた有機EL素子の透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に15Vの直流電圧を印加（アノード：＋、カソード：－）したところ、オレンジ色の発光が確認できた。

#### 【0085】

尚、上述の透明導電アノード電極層の透過率及びヘイズ値は、透明導電アノード電極層だけの値であり、それぞれ下記計算式1及び2により求められる。

##### 〔計算式1〕

透明導電アノード電極層の透過率（%）＝〔（透明導電アノード電極層形成後の積層体ごと測定した透過率）／（透明導電アノード電極層形成前の積層体又は基板の透過率）〕×100

##### 〔計算式2〕

透明導電アノード電極層のヘイズ値（%）＝（透明導電アノード電極層形成後の積層体ごと測定したヘイズ値）－（透明導電アノード電極層形成前の積層体又は基板のヘイズ値）

#### 【0086】

また、透明導電アノード電極層の表面抵抗は、三菱化学（株）製の表面抵抗計ロレスタAP（MCP-T400）を用いて測定した。ヘイズ値と可視光透過率は、村上色彩技術研究所製のヘイズメーター（HR-200）を用いて測定した。また、連鎖状凝集金コート銀微粒子の形状、粒子サイズ（長さ）は、日本電子製の透過電子顕微鏡で評価した。

#### 【0087】

##### 〔実施例2〕

ポリスチレンスルホン酸がドーブされたポリエチレンジオキシチオフェン（PEDOT：PSS）分散液（バイエル社製、バイترونP-VP-CH8000）を、有機溶媒に希釈してホール注入層形成用塗布液を調整した。このホール注入層形成用塗布液の組成は、バイترونP-VP-CH8000：20.0%、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン：1.0%、N-メチル-2-ピロリドン：1.5%、PGM：5.0%、イソプロピルアルコール（IPA）：72.5%であった。

#### 【0088】

平滑な基板としてのPETフィルム（帝人（株）製、厚さ100μm）を40℃に予熱した後、その上に上記ホール注入層形成用塗布液をスピンコーティング（150rpm、



100秒間)し、120℃で10分間加熱処理して、ホール注入層を形成した。

#### 【0089】

更に、平滑な基板を40℃に予熱した後、上記ホール注入層上に、実施例1と同じ透明導電アノード電極層形成用塗布液をスピンコーティング(130rpm、100秒間)し、120℃で10分間加熱処理して、透明導電アノード電極層を形成した。この透明導電アノード電極層の膜特性は、実施例1と同様の方法で測定した結果、可視光透過率=75%、ヘイズ値=0.2%、表面抵抗値=200Ω/□であった。

#### 【0090】

上記透明導電アノード電極層上にエポキシ系接着剤を塗布した後、透明基材としてのガラス基板(ソーダライムガラス、厚さ1mm)に貼り合わせ、接着剤を硬化させて、平滑な基板/ホール注入層/透明導電アノード電極層/接着剤層/透明基材からなる実施例2に係る透明導電積層体を得た。この透明導電積層体において、平滑な基板としてのPETフィルムは、ホール注入層との接着界面で簡単に剥離することができた。

#### 【0091】

上記透明導電積層体から平滑な基板(PETフィルム)を剥離して得られたホール注入層の平滑な剥離面上に、透明基材を40℃に予熱した後、実施例1と同じポリマー発光層形成用塗布液をスピンコーティング(150rpm、60秒間)し、更に80℃で60分間真空加熱処理して、ポリマー発光層を形成した。

#### 【0092】

このポリマー発光層上に、カルシウム(Ca)、銀(Ag)の順番で真空蒸着を行い、CaとAgからなる2層のカソード電極層(サイズ:1cm×1.5cm)を形成して、実施例2に係る有機EL素子を得た。この有機EL素子の透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に15Vの直流電圧を印加(アノード:＋、カソード:－)したところ、オレンジ色の発光が確認できた。

#### 【0093】

##### 【実施例3】

実施例2と同様に、平滑な基板上にホール注入層と透明導電アノード電極層を形成した後、更に続けてシリカゾル液を主成分とする透明コート層形成用塗布液をスピンコーティング(130rpm、80秒間)し、120℃で10分間加熱処理して、透明コート層を形成した。この透明導電アノード電極層/透明コート層からなる2層膜の膜特性は、実施例1と同様の方法で測定した結果、可視光透過率=76%、ヘイズ値=0.2%、表面抵抗値=180Ω/□であった。

#### 【0094】

上記透明コート層形成用塗布液の組成は、シリカゾル液(SiO<sub>2</sub>=10%):5.0%、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン:0.005%、PGM:10.0%、DAA:5.0%、EA:79.9%であった。また、上記シリカゾル液は、メチルシリケート51(コルコート社製、商品名)を19.6部、エタノール57.8部、1%硝酸水溶液7.9部、純水14.7部を用いて、SiO<sub>2</sub>(酸化ケイ素)固形分濃度が10%で、重量平均分子量が1400となるように調製したものである。

#### 【0095】

上記透明コート層上にエポキシ系接着剤を塗布した後、透明基材としてのガラス基板(ソーダライムガラス、厚さ1mm)に貼り合わせ、接着剤を硬化させて、平滑な基板/ホール注入層/透明導電アノード電極層/透明コート層/接着剤層/透明基材からなる実施例3に係る透明導電積層体を得た。この透明導電積層体において、平滑な基板としてのPETフィルムは、ホール注入層との界面で簡単に剥離することができた。

#### 【0096】

上記透明導電積層体から平滑な基板(PETフィルム)を剥離し、実施例2と同様にして、ポリマー発光層と、CaとAgからなる2層のカソード電極層を形成して、実施例3に係る有機EL素子を得た。この有機EL素子の透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に15Vの直流電圧を印加(アノード:＋、カソード:－)したところ、オレンジ

色の発光が確認できた。

【0097】

[比較例]

40℃に予熱したガラス基板（ソーダライムガラス、厚さ1mm）上に、実施例1で用いた透明導電アノード電極層形成用塗布液をスピンコーティング（130rpm、100秒間）し、120℃で10分間加熱処理して、ガラス基板上に透明導電アノード電極層を形成した。この透明導電アノード電極層の膜特性は、可視光透過率=77%、ヘイズ値=0.1%、抵抗値=125Ω/□であった。

【0098】

上記透明導電アノード電極層を形成したガラス基板を40℃に予熱した後、透明導電アノード電極層上に、実施例1と同じポリマー発光層形成用塗布液をスピンコーティング（150rpm、60秒間）し、80℃で60分間真空加熱処理して、ポリマー発光層を形成した。このポリマー発光層上に、実施例1と同様にして、CaとAgからなる2層のカソード電極層（サイズ：1cm×1.5cm）を形成し、比較例1に係る有機EL素子を得た。

【0099】

上記と同じ手順で比較例1に係る有機EL素子を10個作製し、各有機EL素子の透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に15Vの直流電圧を印加（アノード：+、カソード：-）したところ、全ての素子において透明導電アノード電極層とカソード電極層の間で電氣的短絡（ショート）が起り、発光は起きなかった。

・【0100】

この比較例の結果から、塗布法により形成された透明導電アノード電極層を備え、これにポリマー発光層とカソード電極層を積層させた従来タイプの有機EL素子の構造では、透明導電アノード電極層とカソード電極層との間で電氣的短絡（ショート）が発生し、安定した発光を得ることが非常に困難なことが判る。一方、上記した本発明の実施例1～3に係る有機EL素子は、塗布法により形成された透明導電アノード電極層を備えているにもかかわらず、直流電圧の印加により安定した発光を確認することができた。

【図面の簡単な説明】

【0101】

【図1】本発明に係る基本的構造の透明導電積層体を示す断面図である。

【図2】本発明に係る基本的構造の有機EL素子で、突起部を模式的に示した断面図である。

【図3】従来の基本的構造の有機EL素子で、突起部を模式的に示した断面図である。

。

【図4】本発明に係る別な構造の透明導電積層体を示す断面図である。

【図5】図4の透明導電積層体から平滑な基板を剥離した状態を示す断面図である。

【図6】図4の透明導電積層体から作製した有機EL素子を示す断面図である。

【図7】本発明に係る更に別な構造の透明導電積層体を示す断面図である。

【図8】図7の透明導電積層体から作製した有機EL素子を示す断面図である。


【図9】本発明に係るパターン形成された透明導電アノード電極層を有する有機EL素子を示す断面図である。

【図10】従来のパターン形成された透明導電アノード電極層を有する有機EL素子を示す断面図である。

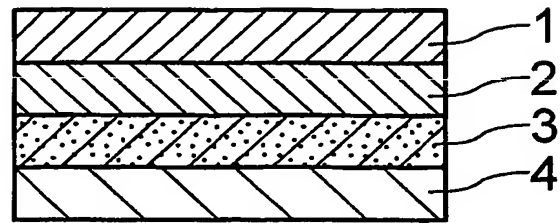
【符号の説明】

【0102】

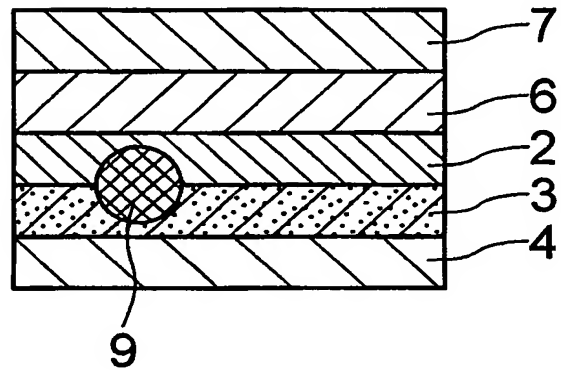
- 1 平滑な基板
- 2 透明導電アノード電極層
- 3 接着剤層
- 4 透明基材
- 5 ホール注入層

- 
- 6 ポリマー発光層
  - 7 カソード電極層
  - 8 透明コート層
  - 9 突起部

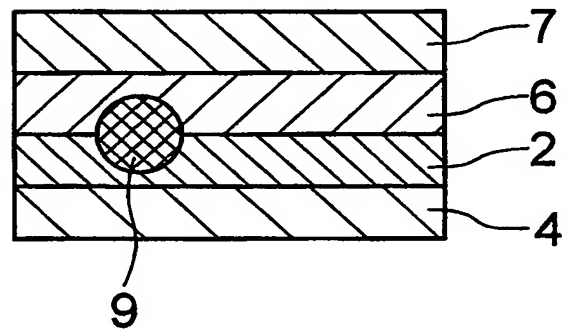
【書類名】 図面  
【図 1】



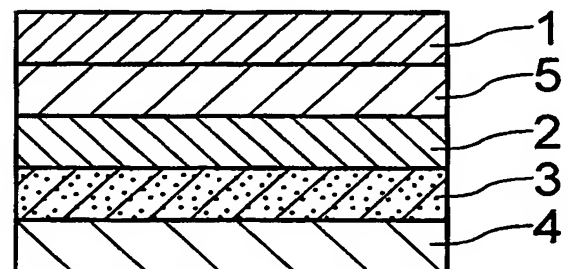
【図 2】



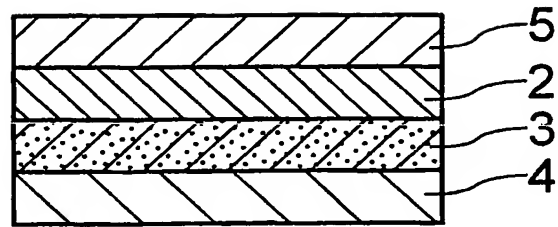
【図 3】



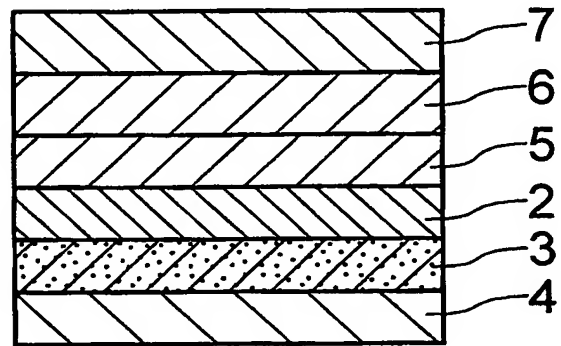
【図 4】



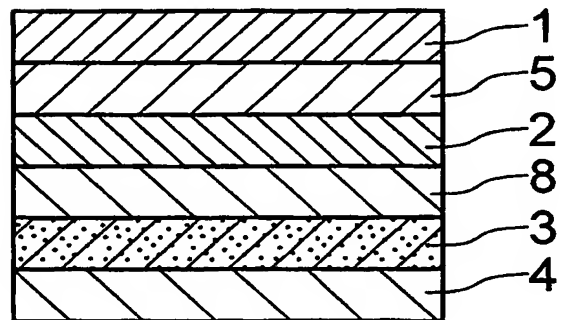
【図 5】



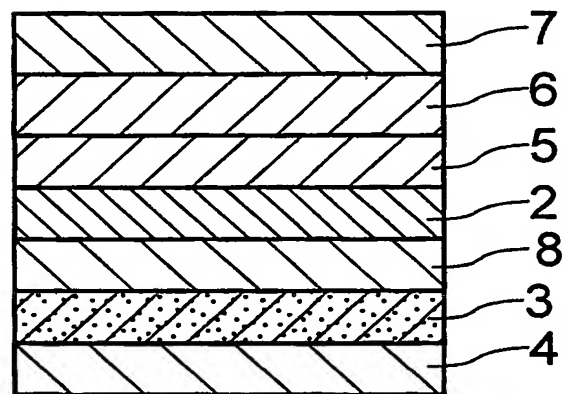
【図 6】



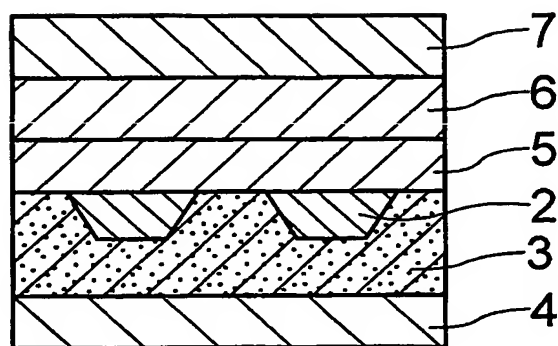
【図 7】



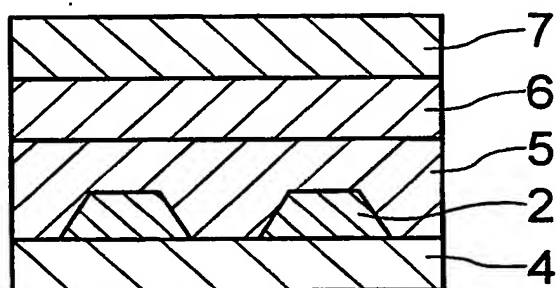
【図 8】



【図 9】



【図 10】



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【目的】 簡便で低温成膜可能な塗布法により形成された透明導電アノード電極層を備えながら、透明導電アノード電極層とカソード電極層の間に電氣的短絡を生じない有機EL素子、その有機EL素子の製造に用いる透明導電積層体を提供する。

【構成】 平滑な基板1上に、導電性微粒子を含む透明導電アノード電極層形成用塗布液を用いて透明導電アノード電極層2を形成し、この透明導電アノード電極層2を透明基材4に接着剤層3で接合して透明導電積層体とする。この透明導電積層体から平滑な基板1を剥離し、透明導電アノード電極層2の剥離面上に、ポリマー発光層及びカソード電極層を順に形成して有機EL素子とする。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 3 - 3 1 5 0 0 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 1 8 3 3 0 3 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区新橋 5 丁目 1 1 番 3 号

氏 名

住友金属鉱山株式会社



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**